



会 社 名 **株式会社サムコインターナショナル研究所** 登録銘柄 (店頭登録銘柄)  
 コード番号 6387 本社所在都道府県 京都府  
 本社所在地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼経理部長  
 氏 名 山田史郎 TEL (075) 621 - 7841  
 決算取締役会開催日 平成 13 年 9 月 25 日 中間配当制度の有無 有  
 定時株主総会開催日 平成 13 年 10 月 26 日

## 1. 13 年 7 月期の業績 (平成 12 年 8 月 1 日 ~ 平成 13 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績 (注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
13 年 7 月期	4,078 ( 30.0 )	902 ( 45.4 )	907 ( 51.6 )
12 年 7 月期	3,136 ( 13.9 )	620 ( 14.9 )	598 ( 12.5 )

	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
13 年 7 月期	471 ( 44.1 )	111.63	-	15.6	15.8	22.3
12 年 7 月期	327 ( 137.8 )	1,529.47	-	22.9	16.1	19.1

(注) 1. 持分法投資損益 13 年 7 月期 - 百万円 12 年 7 月期 - 百万円  
 2. 期中平均株式数 13 年 7 月期 4,226,780 株 12 年 7 月期 213,996 株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

	1 株 当 た り 年 間 配 当 金			配 当 金 総 額 (年 間)	配 当 性 向	株 主 資 本 配 当 率
	中 間	期 末				
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
13 年 7 月期	12.50	-	12.50	61	13.0	1.4
12 年 7 月期	100.00	-	100.00	21	6.5	1.3

(注) 13 年 7 月期期末配当金の内訳 普通配当 10 円 00 銭、株式店頭上場記念配当 2 円 50 銭

## (3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
13 年 7 月期	7,574	4,419	58.3	903.62
12 年 7 月期	3,934	1,640	41.7	6,015.00

(注) 期末発行済株式数 13 年 7 月期 4,890,890 株 12 年 7 月期 272,726 株

## (4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	投 資 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	財 務 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
13 年 7 月期	441	2,502	2,881	1,717
12 年 7 月期	451	255	91	886

## 2. 14 年 7 月期の業績予想 (平成 13 年 8 月 1 日 ~ 平成 14 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	1,800	258	149	0.00		
通 期	4,100	775	474		12.50	12.50

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 96 円 92 銭

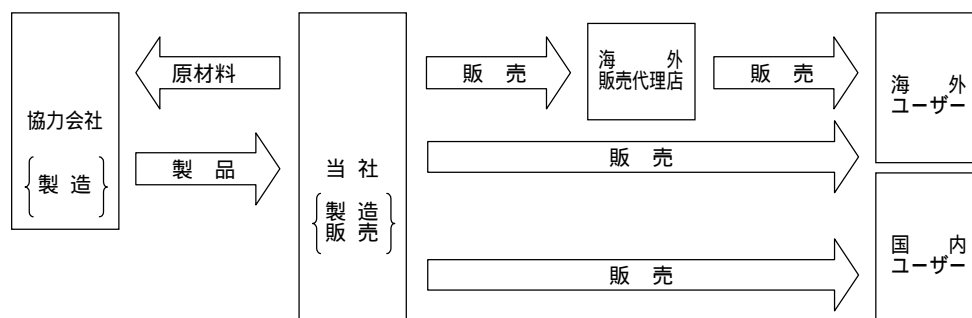
(添付資料)

## 1. 企業集団の状況

当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを主眼とし、半導体等電子部品(主として、オプトデバイス、表示デバイス、水晶部品)製造装置の開発、製造、販売及び製品の保守メンテナンス業務を主業務としております。製品の製造に関しては主に協力会社に製造を委託し、海外における販売活動に関しては主に現地販売代理店に販売を委託しております。これらの関係を図示すると以下のとおりとなっております。

(業態系統図)



なお、当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、品目別に記載を行っており、品目別の内容は以下のとおりであります。

(CVD装置)

減圧下で反応性ガスのプラズマ放電分解作用によって薄膜を形成する装置であり、半導体製造工程等における絶縁膜、光学薄膜等を形成する装置であります。主として半導体等電子部品製造工程の前工程であるウエハー処理工程で使用されています。

(エッチング装置)

減圧下の反応ガスプラズマと中性活性種の相乗効果を利用してエッチングを行う装置であり、主として半導体等電子部品製造工程の前工程であるウエハー処理工程で使用されています。

(洗浄装置)

減圧下の反応ガスプラズマもしくは紫外線とオゾン等を利用して基板表面の洗浄を行う装置であり、主として半導体等電子部品製造工程の後工程である組立工程で使用されています。

(その他装置)

高速熱処理装置や上記品目に含まれない特注品等であります。

(その他)

部品、保守メンテナンス等であります。

## 2. 経営方針及び経営成績

### (1) 経営の基本方針

当社は「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営の基本理念としており、社員の独創性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送り出す。

直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。

事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、役員、従業員に対し適切な成果の配分を約束する。

以上を企業運営の基本方針として事業展開をしております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けており、経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

### (3) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、当面、消費の低迷が続き、厳しい状況下で推移することが予想されます。また、低迷が続くわが国経済を牽引してきた情報通信投資も、米国景気減速の影響を受け、不透明感は強まっております。

当社が手がけております半導体等電子部品製造装置は、進展する高度情報化社会における情報通信技術のキーテクノロジーとして、在庫調整などの一時的な調整局面はありますが、中長期的には一層の成長が見込まれる分野であります。

しかしながら、この分野は顧客ニーズの多様化と高度化に対してグローバルで熾烈な技術開発競争が行われており、技術開発の遅れが市場での競争優位を失う結果となるリスクが高い分野であります。

このような状況下、当社といたしましては、グローバルな研究開発体制を展開し、多様化、高度化する顧客ニーズに即応した次世代新製品開発をより迅速かつ強力に推進し、品質・機能・価格における製品競争力の強化に努めてまいります。また、社内体制の整備を継続して行い、効率的な業務運営に努めることにより全社を挙げて業績のさらなる向上と長期安定的な経営基盤の構築に向け努力いたす所存であります。

### (4) 当期の業績の概要

当期におけるわが国経済は、企業収益の回復や生産の増加を背景に、設備投資はIT（情報技術）関連を中心に増加傾向が見られたものの、雇用不安や所得環境の厳しさなど長引く不況の影響から個人消費には依然として回復感に乏しく、さらに、下期には、米国景気減速の影響を受け、景気に対する不透明感は強まってまいりました。

当社が参画します半導体等電子部品製造装置市場は、上期は世界的に旺盛な半導体需要、アジア経済の回復、国内の情報化投資の増加などを背景に順調に推移いたしましたが、下期にかけて米国を中心としたIT関連分野の成長鈍化に伴い、半導体等電子部品需要が大きく減速し、先行きに不透明感が強まっております。

このような状況のもとで、当社は次世代情報通信産業のキーデバイスである半導体レーザー、LEDなどオプトエレクトロニクス分野を中心として積極的な研究開発活動と営業活動を継続してまいりました。

この結果、当期の売上高は前期比 30.0%増の 4,078,446 千円、経常利益は前期比 51.6%増の 907,856 千円、当期純利益は前期比 44.1%増の 471,838 千円を計上することができました。なお、平成 13 年 5 月 30 日付をもって当社株式を日本証券業協会店頭市場に上場いたしました。

主な品目別の業績は次のとおりであります。

#### (CVD装置)

光通信において光ファイバーをつなぐ重要なモジュールである光導波路製造用途や、半導体レーザー、LEDなど化合物半導体加工用途として、高速成膜装置STシリーズ、高密度プラズマICP-CVD装置を中心に実績を伸ばし、売上高は1,176,602千円（前期比19.0%増）となりました。

#### (エッチング装置)

高密度プラズマICP-エッチング装置やコンパクトエッチング装置RIE-10NRシリーズを中心に半導体レーザー、LEDなど化合物半導体加工用途を中心に堅調に推移し、売上高は1,861,711千円（前期比29.6%増）となりました。

#### (洗浄装置)

実装用自動基盤洗浄装置PXA-200Nが好調だったことなどから、売上高は548,176千円（前期比46.8%増）となりました。

#### (品目別売上高)

品目	売上高(千円)	構成比(%)	前期比(%)
CVD装置	1,176,602	28.8	119.0
エッチング装置	1,861,711	45.7	129.6
洗浄装置	548,176	13.4	146.8
その他装置	150,169	3.7	187.1
その他	341,786	8.4	132.6
合計	4,078,446	100.0	130.0

#### (5) 次期の見通し

今後のわが国経済は、米国経済の減速や構造改革に伴う雇用不安、個人消費の低迷等により、景気の先行きは予断を許さない状況にあり、引き続き厳しい状況が続くことが予想されます。

当社が参画します半導体等電子部品製造装置市場は、米国を中心としたIT関連分野の成長鈍化に伴い、半導体等電子部品需要が大きく減速し、それらに伴う在庫調整等により厳しい事業環境が予想されます。しかしながら、当社が手がけている半導体等電子部品製造装置は、進展する高度情報化社会における情報通信技術のキーテクノロジーとして、一時的な調整局面はありますが、中長期的には一層の成長が見込まれ、調整局面の現在におきましてもナノテクノロジー関連を中心として依然、活発な研究開発が行なわれている分野であります。また、現在の調整局面は、下期には一服し、回復基調に入ると考えております。

このような状況のもと、次期の業績見通しといたしましては、量産工程向け設備投資額の減額による影響も、当社の強みの一つである研究開発向け製造装置が下支えし、売上高は4,100百万円の前期比横ばい、経常利益は775百万円、当期純利益は474百万円を予想しております。なお、品目別の売上高は、CVD装置1,312百万円、エッチング装置1,927百万円、洗浄装置615百万円、その他装置41百万円、その他205百万円を見込んでおります。